

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
14. November 2002 (14.11.2002)

PCT

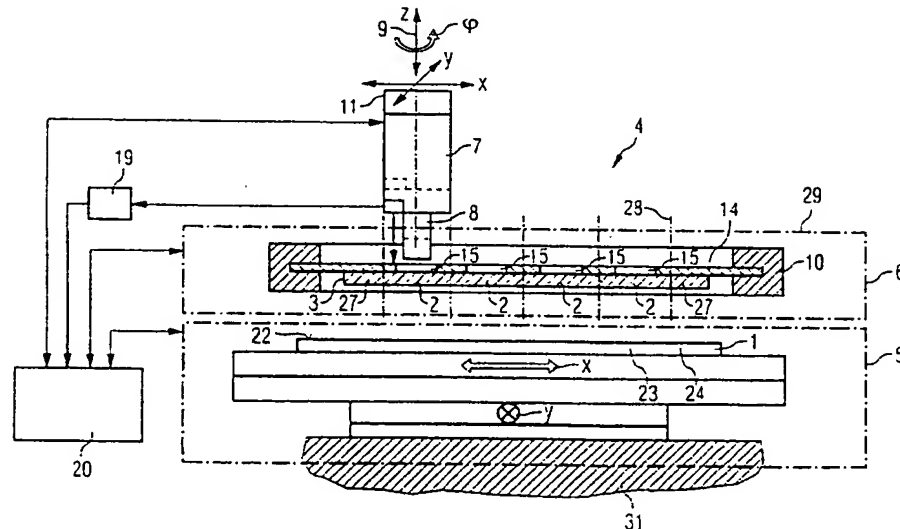
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/091812 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation: H05K 13/04 (72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GEBAUER, Uta
[DE/DE]; Sebastian-Bauer-Strasse 17, 81737 München
(DE). HÖGERL, Jürgen [DE/DE]; Hofweg 28 a, 93053
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE02/01523 Regensburg (DE). POHL, Jens [DE/DE]; Sudetenstrasse
(22) Internationales Anmeldedatum: 25. April 2002 (25.04.2002) 5a, 93170 Bernhardswald (DE). WENNEMUTH, Ingo
[DE/DE]; Josephsburgstrasse 146 A, 81825 München
(DE).
(25) Einreichungssprache: Deutsch
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (74) Anwalt: SCHWEIGER, Martin; Karl-Theodor-Strasse
69, 80803 München (DE).
(30) Angaben zur Priorität: 101 21 578.9 3. Mai 2001 (03.05.2001) DE (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, KR, US.
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.- BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
Martin-Strasse 53, 81669 München (DE). NL, PT, SE, TR).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND COMPONENT SYSTEM FOR PROVIDING A SUBSTRATE WITH ELECTRONIC COMPONENTS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND BESTÜCKUNGSSYSTEM ZUM BESTÜCKEN EINES SUBSTRATS MITELEKTRO-
NISCHEN BAUTEILEN



(57) Abstract: The invention relates to a method and a component system (4) for providing a substrate (1) with an electronic component (2). The component system (4) comprises a substrate carrying device (5) for receiving the substrate, a wafer carrying device (6) placed over the substrate carrying device (5) for receiving a wafer carrying frame (10), as well as a vacuum pincette-holder device (7) placed above the wafer carrying device (6). The wafer carrying frame (10) can receive a complete semiconductor wafer (3) divided into electronic components.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 02/091812 A1

**Veröffentlicht:**

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Docket # HAS-FIN-207
Applic. # _____
Applicant: Jürgen Högerl et al.
Lerner and Greenberg, P.A.
Post Office Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480
Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein Bestückungssystem (4) zum Bestücken eines Substrats (1) mit einem elektronischen Bauteil (2). Dazu weist das Bestückungssystem (4) eine Substrathalteeinrichtung (5) zur Aufnahme des Substrats (1), eine oberhalb der Substrathalteeinrichtung (5) Waferhalteeinrichtung (6) zur Aufnahme eines Waferhalterahmens (10) und eine oberhalb der Waferhalteeinrichtung (6) angeordnete Vakuumpinzetten-Halteeinrichtung (7) auf. Dazu kann der Waferhalterahmen (10) einen kompletten in elektronische Bauteile geteilten Halbleiterwafer (3) aufnehmen.